

針對新世代5G應用所推出的高速可靠解決方案

容量更大:最高容量提升4倍速度更快:整體速度提升2倍電源管理:模組內建電源管理IC

高效省電:低功耗設計,電壓降至1.1伏特靈活整合:升級至I3C Basic系統管理匯流排

• 更加可靠:透過On-die ECC除錯功能提升模組穩定度

相較於DDR4,宜鼎全新DDR5更加迅速可靠,不論是面對HPC高效能運算、5G網通、深度學習、AI人工智慧、邊緣運算、智慧醫療或超級運算,均可滿足這些5G應用對於容量、吞吐量與低延遲的需求,展現高速及廣連結的效能。DDR5能突破過往DDR4固有設計限制,迎來更高頻寬、更高記憶體密度與更低的整體功耗,成為嶄新現代應用的最佳記憶體解決方案。

產品特色



4倍容量

在空間不變的情況下實現容量最佳 化,進而提升整體資料傳輸效率。 最大IC容量增為64GB,不但是 DDR4的四倍,最高容量更可擴增 至128GB。



模組內建電源管理IC

將原本置於主機板的電源管理IC 改為模組內建,進而實現控制系 統電源負載,強化抗干擾能力、 訊號完整性與電源管理。

2倍速度

每組DIMM均擁有獨立32bit雙通道,再加上突發長度從8(BL8)增為16(BL16),速度可從原有的3200MT/s倍增至6400MT/s。



I3C Basic匯流排

DDR5系統管理所採用的JEDEC 模組邊帶匯流排規格(JESD403) 為MIPI I3C Basic版本,與DDR4 模組的I2C相比,效能更佳。





低功率設計

電壓從1.2V降至1.1V,有效減少整體功耗。記憶體模組內建電源管理IC,可部分抑制低電壓所造成的雜訊干擾。



On-die ECC除錯

DDR5支援晶粒內建除錯(On-die ECC)機制,每128bit資料就附帶8bit除錯碼,有效提供強化保障,防止資料遺失。

抗硫化技術 (免費) 宜鼎 DDR4 和 DDR5全系列產品一律免費升級抗硫化技術,展現強固性能。

	DDR4	DDR5
最大IC容量	16Gbit	64Gbit
記憶體容量(SODIMM/UDIMM/RDIMM/ECC DIMM)	2GB~32GB	16GB~128GB
最大資料速率 (MT/s)	2133~3200	4800~6400
電壓 (Vdd)	1.2V	1.1V
電源管理	主機板	電源管理IC (DIMM)
通道數	每個DIMM僅1條子通道 標準品:64bit,ECC:72bit	每個DIMM共2條子通道 標準品:64bit (2x32bit),ECC:80bit (2x40bit)
SPD介面	I2C	I3C
工作溫度	0~85°C	0~85°C